

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
 电话：(86 752) 5533798 传真：(86 752) 5533798-811

产品描述:

Tacusil U20040 为光学组件填缝用光固化环氧树脂。该树脂固化后具有良好的粘结性能、耐冷热冲击特性和低收缩率。该产品可以在UV光照射下固化，但若为了获取最佳的光学特性，除了将树脂放置在UV光源照射外，还可以增加加热固化的制程。

产品特性:

- 该产品不会产生副产品，在固化过程中具有良好的低体积收缩率
- 可应用在电子设备填缝，并可适用于点胶设备
- 可在玻璃、金属和ITO上产生良好的粘结性
- 在环境加速实验后，仍能维持很高的强度。
- 该产品为无溶剂和低污染型环氧树脂
- 产品符合2011/65/EU ROHS 法规

典型性能: 以下所有数据都在25°C条件测定。

特性:	数值:	单位:
颜色/状态	乳白色液体	
黏度25°C, S14 100rpm	7,900 -12,000	cps
比重	1.19	
硬度	78	Shore D
触变指数	1.95	
可使用时间 , 25°C	2	Days
建议的固化条件	建议照射波长: 310-430 nm 建议照射光强: >50 mW/cm2 建议照射能量: 3000-6000mJ/cm2 后加热时间: 80°C, 60 min	
玻璃转化温度(MDSC)	60	°C
吸水率 (25°C/ 24hr)	1.00	%
(80°C/ 24hr)	4.81	%
(97°C/ 1.5hr)	2.60	%

公司对产品的适用性，商销性等不作任何明示或暗示的保证。此外，以上信息准备无误，属实可靠；但是，我们不对数据的准确性或使用数据获得的结果作任何明示或暗示的保证。由于客户使用产品的条件在我们控制之外，我们不对产品使用建议做任何保证。以上提供的典型性质值，不可当作产品的规格数据使用。用户需要对产品进行测试以确定其具体用途的适用性。

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房

电话：(86 752) 5533798 传真：(86 752) 5533798-811

热裂解温度 (TGA 10°C/min)	232	°C
重量损失率 @100 °C	1.52	%
@150 °C	2.31	%
@200 °C	3.58	%
@250 °C	5.39	%
@300 °C	9.05	%
@350 °C	16.06	%

注：试片的固化条件： 3,000mJ/cm² +80°C/1hr

使用指南：

- 该产品需冷冻（-40°C ~ -5°C）储存，使用前需将产品放置室温下（14~34°C）1~2小时回温。在尚未回温前，请勿打开盖子，以免影响产品的特性。
- 使用前需先将粘结表面清洁干净。建议先用有机溶剂擦拭表面，防止灰尘，油渍，脱模剂等影响粘结性能。
- 结束加热制程后，让产品缓慢降温可减少产品的内应力。
- 某些特定物质可能会抑制树脂的反应能力，例如胺类，胺类固化的环氧树脂，聚胺基甲酸酯（PU）...等，直接或间接的接触到上述物质都有可能对树脂的反应速率降低，甚至于无法进行反应。有上述疑虑时，可将树脂涂布在一小区域的材料上实验进行确认。

储存环境：

该产品需隔绝湿气和热原，以确保储存稳定性。在未开封前储存于（-40°C ~ -5°C）的低温环境，保质期为8个月。请将该产品放置在室温（14~34°C）下回温1-2小时后可正常使用，并请尽快使用完毕。如果室温下放置过久，将导致产品特性发生变化。

公司对产品的适用性，商销性等不作任何明示或暗示的保证。此外，以上信息准备无误，属实可靠；但是，我们不对数据的准确性或使用数据获得的结果作任何明示或暗示的保证。由于客户使用产品的条件在我们控制之外，我们不对产品使用建议做任何保证。以上提供的典型性质值，不可当作产品的规格数据使用。用户需要对产品进行测试以确定其具体用途的适用性。